

TeSP - Instalações Elétricas e Manutenção Industrial

Técnico Superior Profissional

Plano: Aviso n.º 11062/2017 – 25/09/2017

Ficha da Unidade Curricular: Manutenção de Sistemas Informáticos Industriais

ECTS: 3; Horas - Totais: 81.0, Contacto e Tipologia, TP:37.50;

Ano|Semestre: 2|S1; Ramo: Tronco comum;

Tipo: Obrigatória; Interação: Presencial; Código: 627318

Área de educação e formação: Electrónica e automação

Docente Responsável

André Filipe Sá e Silva

Docente e horas de contacto

André Filipe Sá e Silva

Assistente Convidado, TP: 37.5;

Objetivos de Aprendizagem

Identificar os componentes físicos dos equipamentos informáticos e compreender suas funcionalidades;
Realizar de forma profissional uma manutenção preventiva e correctiva a equipamentos informáticos; Criar relatórios de diagnóstico das principais avarias dos equipamentos informáticos.

Conteúdos Programáticos

1. Técnicas de Pré-diagnóstico de avarias em equipamento informáticos
2. Técnicas de montagem e desmontagem de equipamentos informáticos
3. Técnicas de manutenção preventiva
 - a. Limpeza de equipamentos informáticos
 - b. Manutenção dos módulos de dissipação térmica e de refrigeração
 - c. Pastas e Pad's térmicos e a sua aplicação
4. Diagnóstico de avarias em equipamentos informáticos
 - a. Avarias de Software
 - i. Sistemas operativos
 - ii. Drivers
 - b. Avarias de Hardware
 - i. Periféricos
 - ii. Dispositivos de interface humana
 - iii. Motherboard
 - iv. Baterias
 - v. Carregadores de baterias
5. Conceitos básicos de electrónica
 - a. Modos de ligação e simbologia dos principais aparelhos de medida.
 - i. Voltímetro

- ii. Amperímetro
- iii. Ohmímetro
- b. Identificação e características de componentes electrónicos
 - i. Resistências
 - ii. Condensadores
 - iii. Bobines
 - iv. Circuitos integrados
 - v. Mosfet
 - vi. Transístores
- c. Técnicas de leitura de esquemas.
 - i. Metodologia de um manual de serviço.
 - ii. Identificação de componentes electrónicos num circuito através do seu esquema
- 6. Técnicas de soldadura a estanho com e sem chumbo, em componentes SMD e DIP.
- 7. Técnicas de manutenção correctiva em equipamentos informáticos
 - a. Reparação e substituição de periféricos
 - b. Reparação de todos os módulos constituintes de uma Motherboard
 - i. Módulo de alimentação primaria e secundaria
 - ii. Módulos de controlo
 - iii. Módulo de vídeo
 - iv. Módulo de processamento
 - c. Substituição de fichas e conectores
 - d. Reparação de baterias
 - e. Reparação de carregadores

Metodologias de avaliação

Teste de avaliação escrito; Trabalhos práticos (discussão/defesa). Teste escrito (60%), trabalhos laboratorial (40%) (é obrigatório uma class. mínima de 45% no teste escrito e uma class. mínima de 45% nos laboratórios e implementação do caso de estudo)

Software utilizado em aula

Não Aplicavel

Estágio

Não Aplicavel

Bibliografia recomendada

- Silva, A. (0). *Apontamentos cedidos pelo docente (PowerPoint)*.. Acedido em 1 de janeiro de 2016 em www.nolink.as

Metodologias de ensino

Aulas teóricas e teóricas/ práticas

Língua de ensino

Português

Pré requisitos

Não Aplicável


Programas Opcionais recomendados

Não Aplicavel

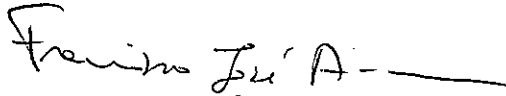
Observações

Conceitos básicos de electrónica / informática


Docente Responsável



Diretor de Curso, Comissão de Curso



Conselho Técnico-Científico



Homologado pelo C.T.C.
Acta n.º 12 Data 17/1/2018
